

## Systeme – MicroTCA

### MicroTCA.4 System, 9 HE, 84 TE, für 12 Double Mid-size-AMC's, White Rabbit, JSM-Slot



Frontansicht

12917001



Rückansicht

12917002

- Gemäß Spezifikation PICMG MTCA.4 R1.0
- 9 HE, 84 TE System für 12 Double Mid-size-AdvancedMC-Module, 2 Double Full-size MCHs und 4 Double Full-size-Power-Module
- 12 Rear-Transition-Module Steckplätze für Double Mid-size RTM's
- Backplane mit Dual-Star Topologie, Direktverbindungen für S-ATA/ SAS, Clock- und Trigger Leitungen gemäß PICMG MTCA.4
- Telecom and Fabric clock Topologie nach PICMG AMC.0 R2.0
- Unterstützt White Rabbit Synchronisierung
- 2 hot-Swap Lüfterkassetten mit Cooling Unit Manager (CU EMMC), Luftführung von unten vorne nach oben hinten
- Lüfterdrehzahl für Front- und Rear- Bereich über den MCH getrennt einstellbar
- Separater JSM-Slot

Das System ist für High-Performance Anwendungen mit hoher Verfügbarkeit konzipiert, bei denen die Redundanz aller Komponenten erforderlich ist. Die beiden redundante Hot swap-Lüfterkassetten mit EMMC in Push-Pull-Anordnung garantieren eine hervorragende Kühlung der Front- und Rear-Slots. Die Lüfterdrehzahl ist für den Front- und Rückbereich getrennt und mittels MCH einstellbar. Der separate JSM-Slot verhindert die Belegung eines AMC-Slots durch ein JTAG-Modul. Kabelwannen an der Front- und Rückseite des Gehäuses erleichtern das Kabelmanagement. Das System kann bis zu vier Power Modules aufnehmen, um eine ausreichende Stromversorgung der Applikation zu gewährleisten. Die Backplane verfügt über Clock- und Trigger-Leitungen gemäß PICMG MTCA.4 und Interlocks. Zusätzlich verfügt sie über Direktverbindungen für SAS/SATA und Leitungen zwischen den AMCs und unterstützt White Rabbit für deterministisches Ethernet.

#### Lieferumfang (komplett montiert, verdrahtet und getestet)

Pos.	Menge	Beschreibung
1	1	MicroTCA-System, 9 HE, 84 TE, 373 mm tief, verzinkt
2	12	AdvancedMC-Modul Steckplatz, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
3	6	RTM-Modul Steckplatz, mit Führungsschiene, für vertikalen Karteneinbau
4	1	Backplane mit Dual-Star Topologie für 12 AdvancedMC-Module, 2 MCH und 4 Power-Module
5	2	Hot-swap-Lüfterkassette mit Cooling Unit Manager (CU EMMC) und 6 Lüftern
6	1	Luftfilter, von vorne auswechselbar

#### Bestellinformationen

Breite	Höhe	Tiefe	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Bestell-Nr.
TE	HE	mm	RTM-Slot	AMC-Slot	MCH-Slot	Power-Slot	
84	9	373,3	12	12	2	4	11850-027

#### Zubehör

AC/DC, Double Full-size, mit Power-Management (PM EMMC) 550 W, 1 Stück	11098-547
--	-----------

#### Hinweis

- Modifizierte Systeme auf Anfrage

12917050

